

# 中国プライムウェーハ事業 に関する合併会社設立について

株式会社RS Technologies  
東証1部：3445

## 注意事項

- 当該資料に記載された内容は、一般的に認識されている経済情勢及び当社が合理的と判断した一定の前提に基づいて作成されておりますが、経営を取りまく様々な環境の変化により、予告なしに変更される可能性があります。
- 本発表において提供される資料ならびに情報の中には「見通し情報」が含まれております。これらの情報は、現在における見込み、予測およびリスクを伴う想定に基づくものであり、実際には異なる結果となる不確実性を含んでおります。
- 今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合であっても、当社は本発表に含まれる「見通し情報」の更新・修正をおこなう義務を負うものではありません。

# 目次

当社の中・長期的な経営方針	P. 4- 8
本件取引の概要	P. 9-11
本件取引の戦略的意義	P.1 2-1 5
会社概要	P.1 6-1 8

# 当社の中・長期的な経営方針

## 中・長期的な経営方針

①台湾子会社・三本木工場の生産力拡大

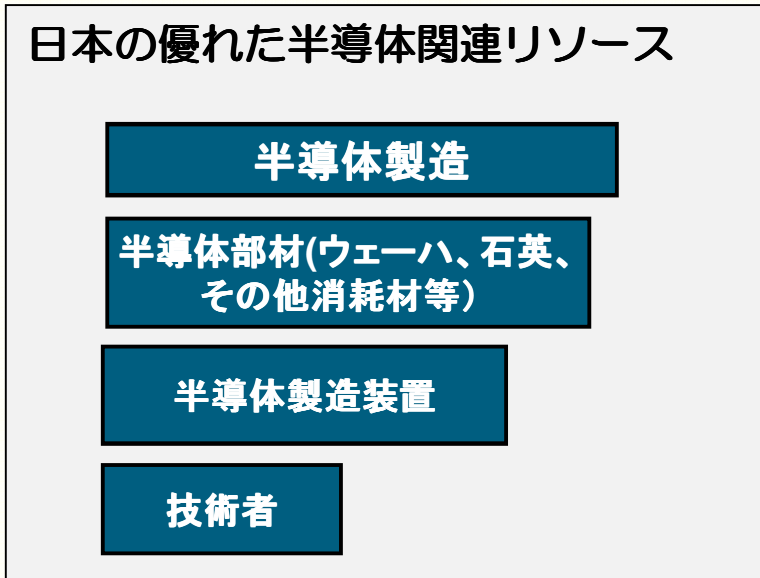
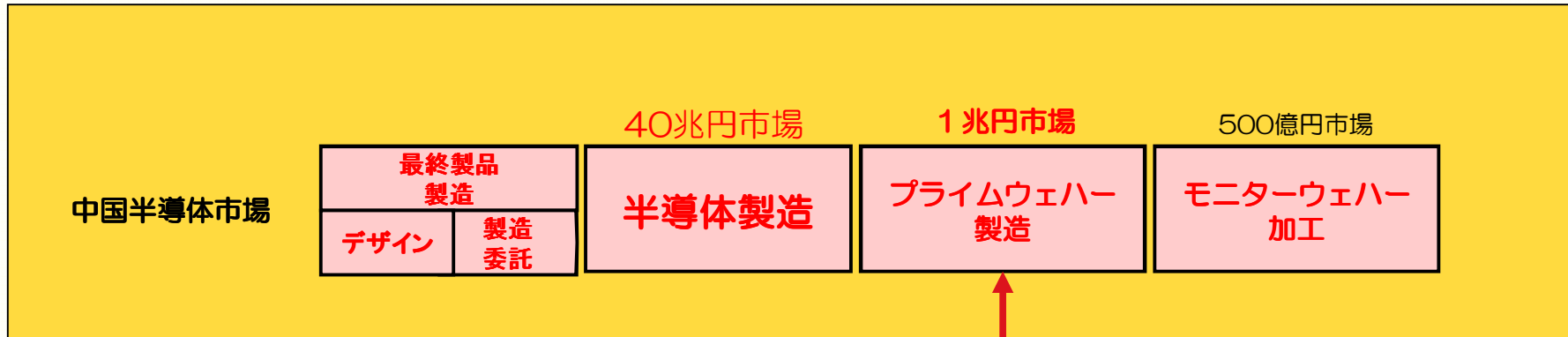
②再生市場での当社のシェア拡大

③伸長する需要の取込み

④潜在的な再生市場の開拓

⑤中国半導体マーケットへの参入 ●今回のトピックス●

# 「中国半導体マーケットへの参入」



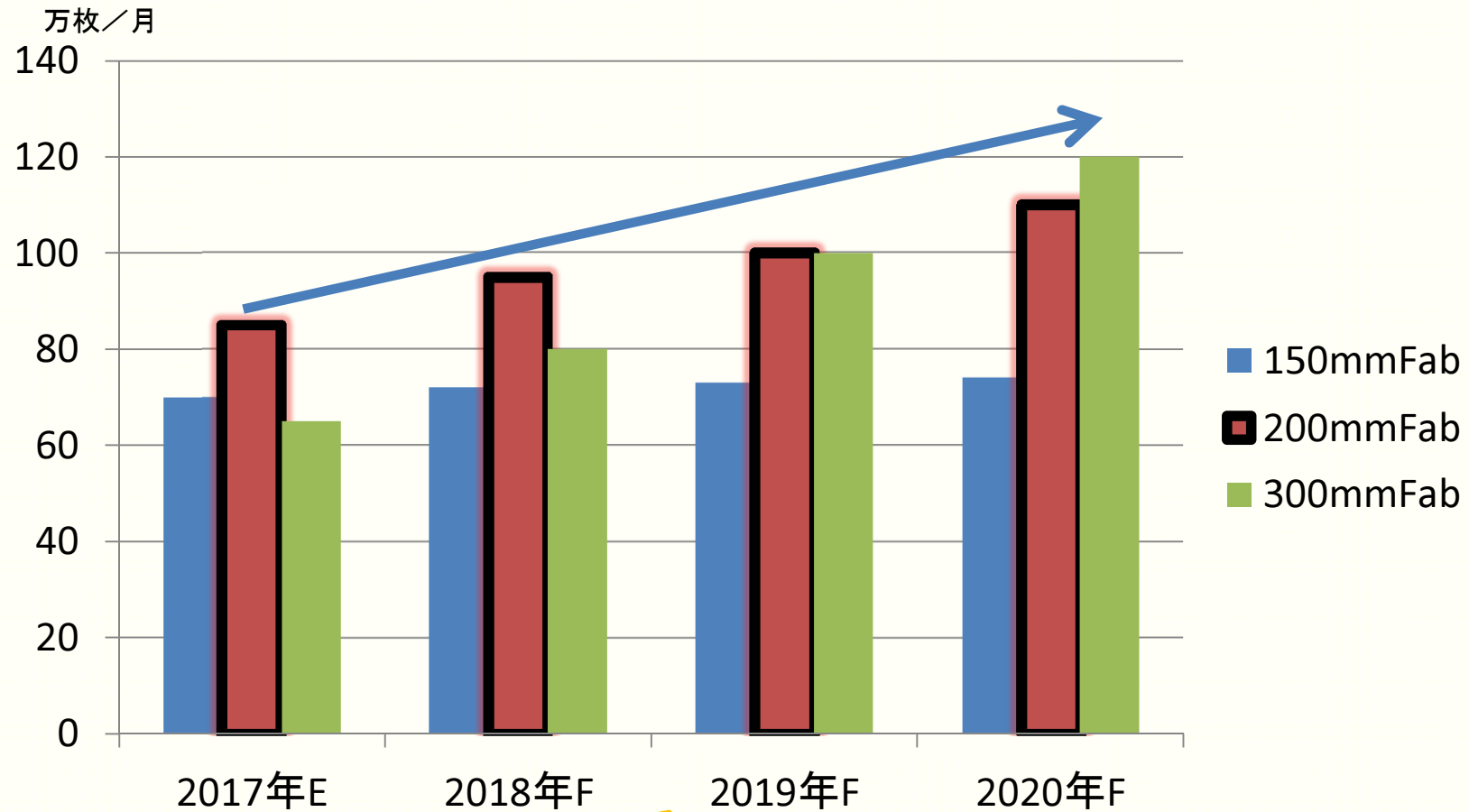
当社再生加工技術を活かし、

## 新規参入



※市場規模は世界における市場規模で各種統計データに基づき、当社が独自に算出しております。

# 「中国半導体Fab生産能力予測」



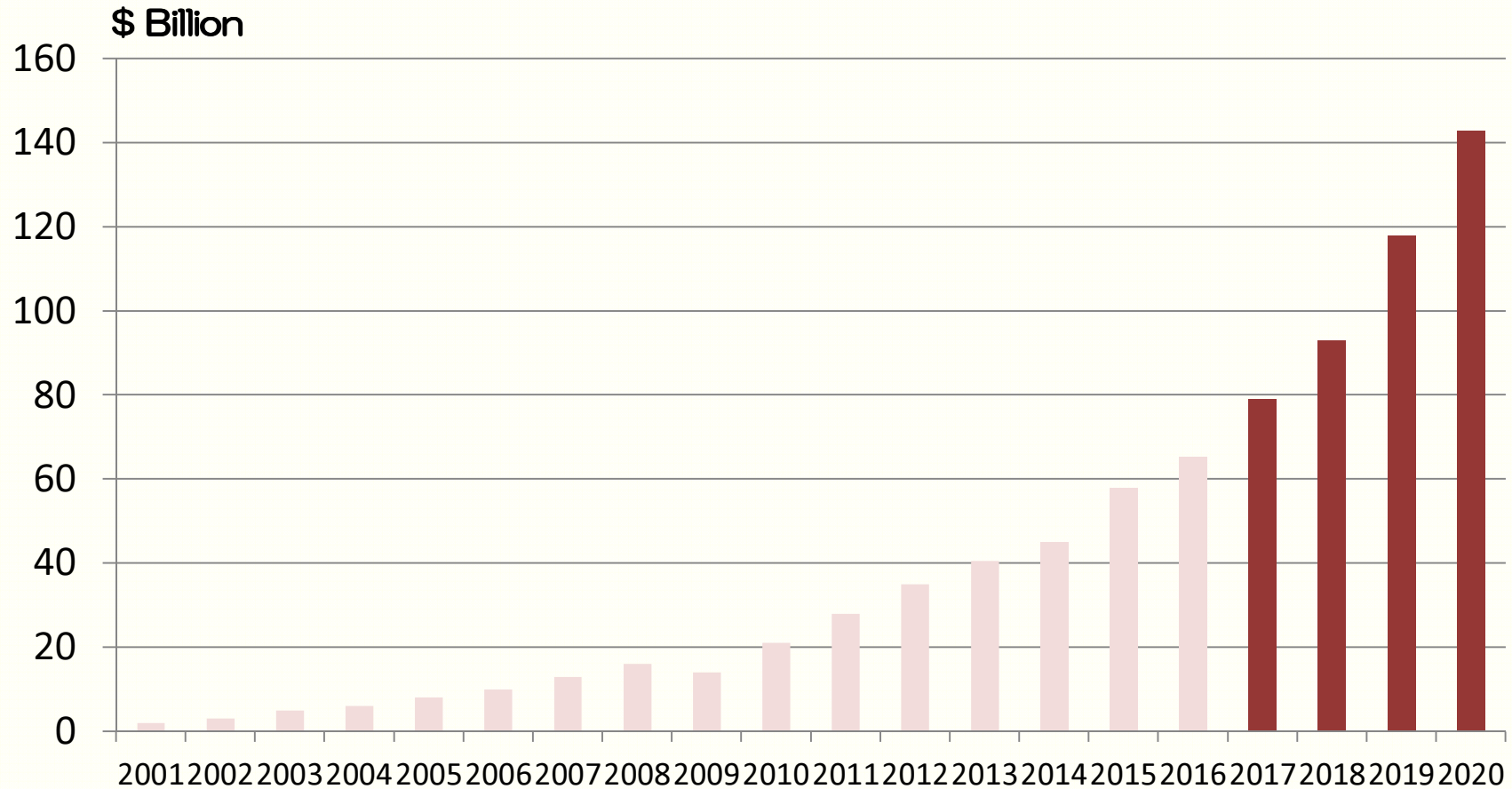
中国は国策で半導体Fabの集積地を目指すため投資を継続。  
一方、シリコンウェーハはプライム、テスト、リクレームとも不足。

**中国現地でのウェーハ需要は強い**

※集成电路材料和零部件产业技术创新战略联盟(ICMtia)資料より抜粋。

# 「中国半導体産業成長予測」

## China IC Industry Revenue and Projection



2020年までに年率20%以上の成長を国が支援。

※SEMI資料より当社加工。



# 本件取引の概要

## 本件取引の概要 ①

当社は北京有色金属研究総院（GRINM）、  
福建倉元投資有限責任公司（福建倉元）と  
3社間で中国における合弁会社（BGRS）  
設立に合意。

当社45%、GRINM49%、福建倉元6%の出資による合弁会社（以下BGRS）の設立に合意。

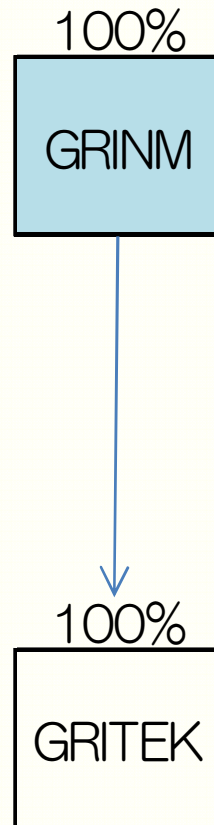
当社は、現状GRINM100%子会社でプライムウェーハ事業を営む  
有研半導体材料有限公司（以下GRITEK）を、BGRSを通じて連結子会社化。

当社は、約62百万USドル（約70億円）を段階的に出資予定。  
当初60%、1年後25%、2年後15%の予定。

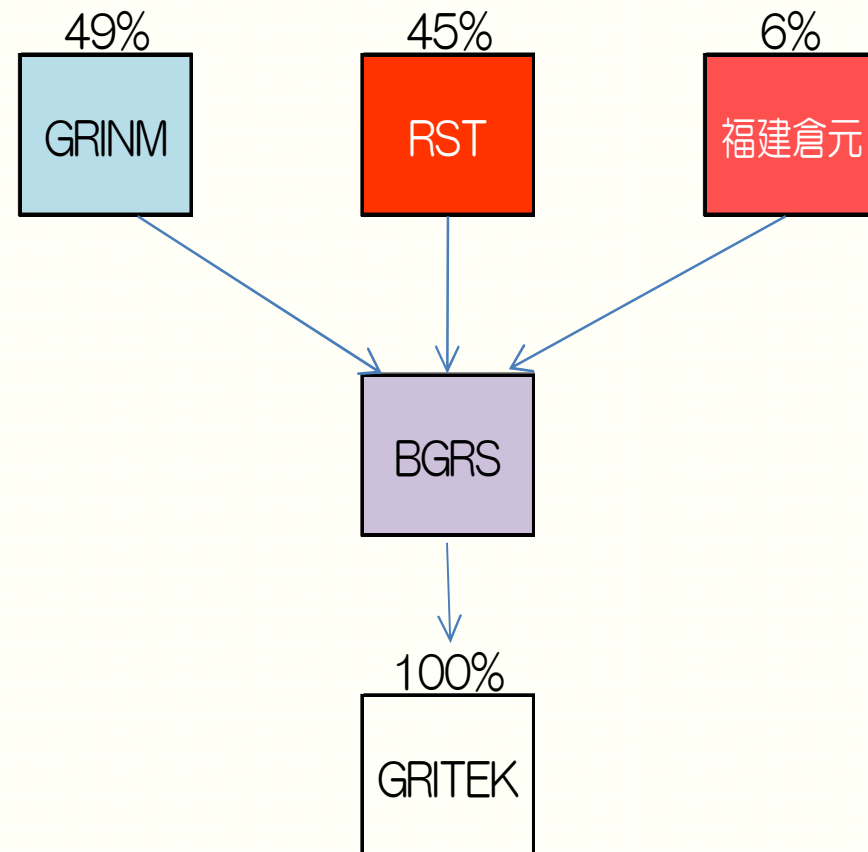
※規制当局その他の同意をはじめとする一般的な取引条件を満たすことを前提にしている。

## 本件取引の概要 ②

本件取引前

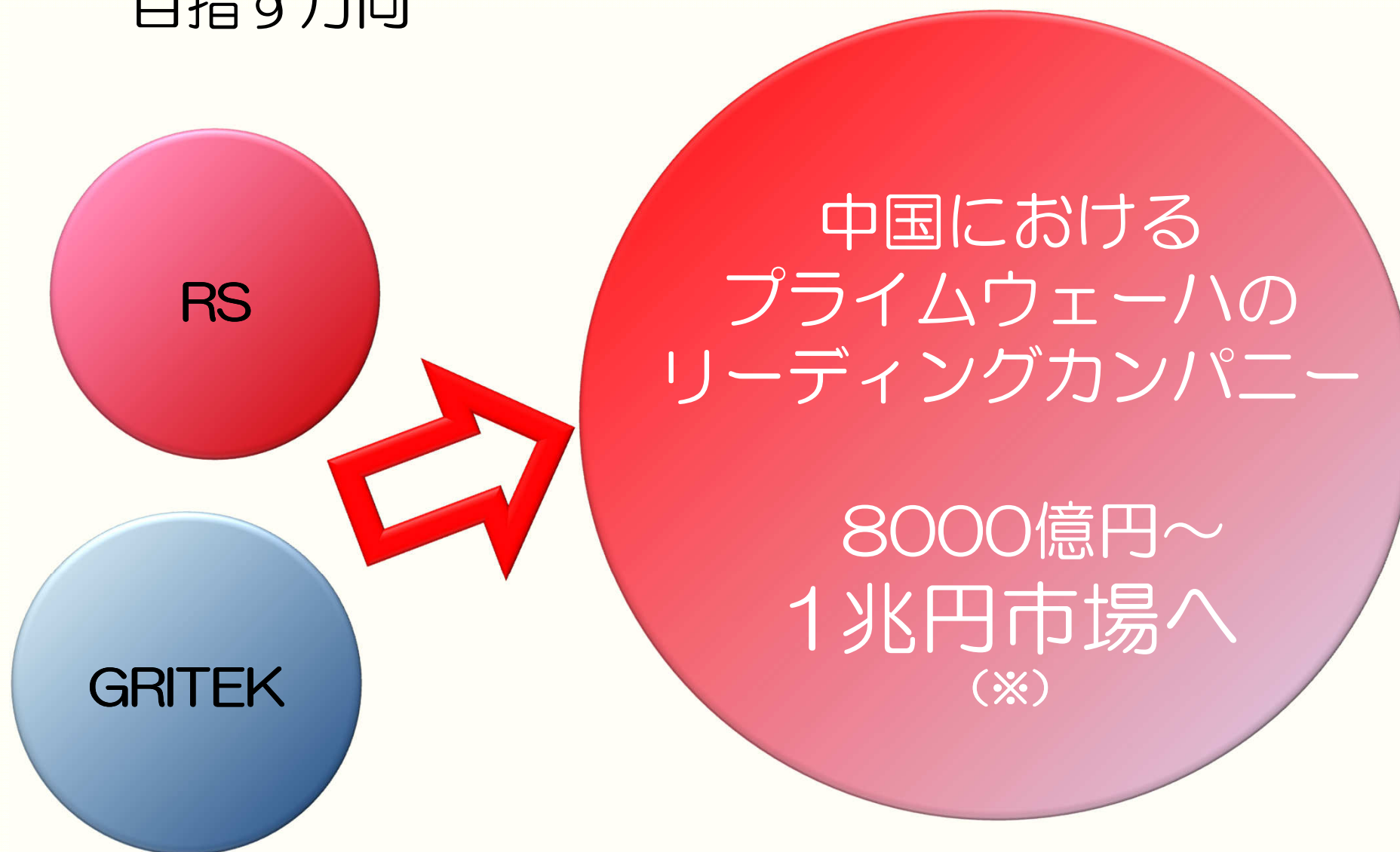


本件取引後



# 本件取引の戦略的意義

## 目指す方向



※業界別の世界市場規模の探求 <http://blog.livedoor.jp/toefl/archives/50766297.html>より抜粋。

# 本件取引の戦略的意義

## 当社の戦略

成長性の高い中国のウェーハ市場において、有力なパートナーと提携し、プライムウェーハ製造販売事業への展開を図る。

GRINMの知名度を生かして、中国国内で半導体生産設備の買取販売事業の更なる取引拡大を図る。



有研半导体材料有限公司  
GRINM Semiconductor Materials Co.,Ltd.

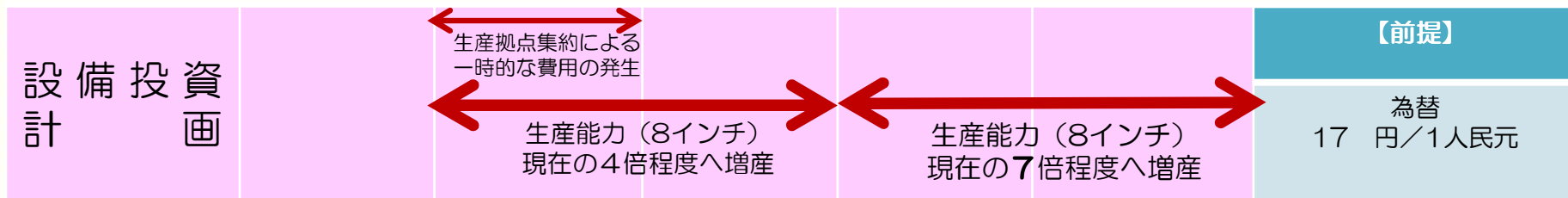
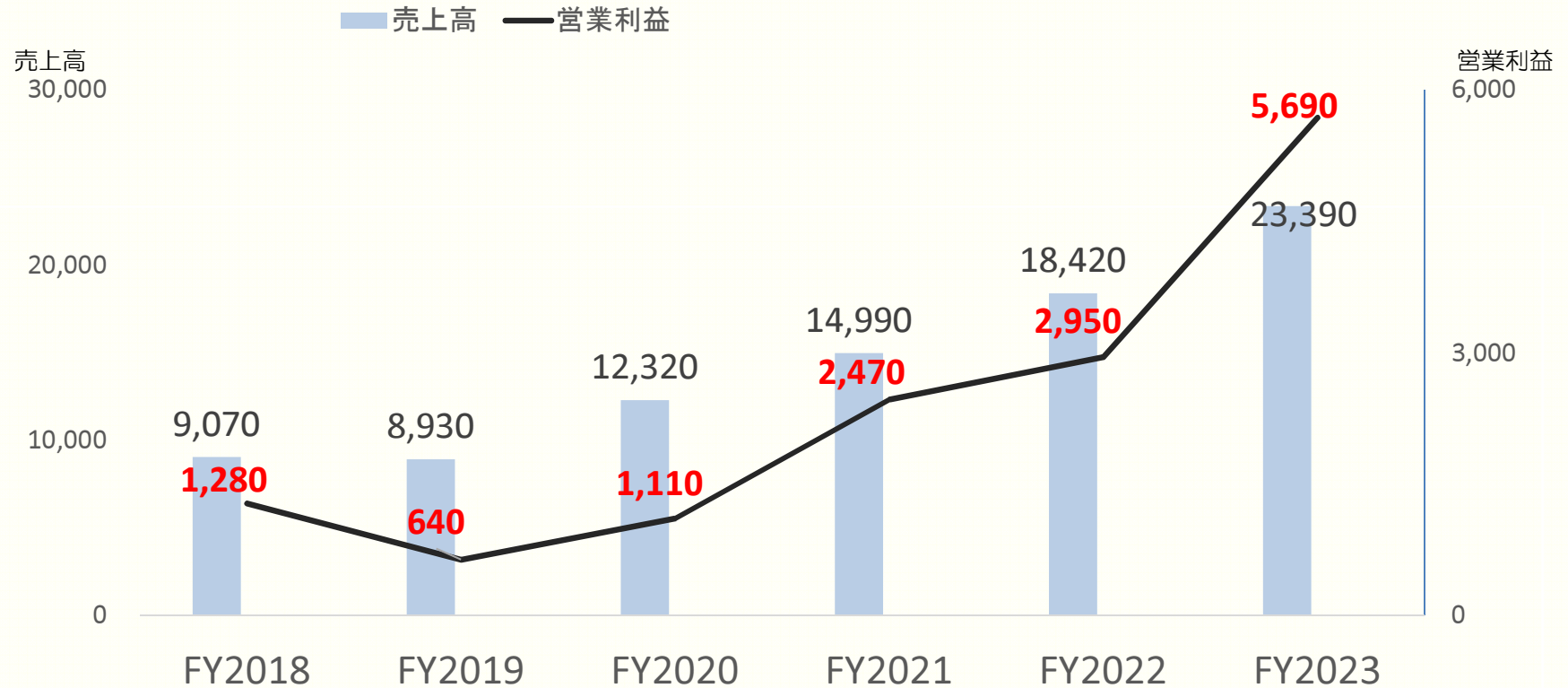
## GRINMの戦略

RSのマネジメント力、ウェーハ加工技術を活かし、今後成長する中国の半導体市場において、プレゼンスを握る。

RSのグローバルな販売力を活用して、世界の半導体メーカーとの取引拡大を図る。

# BGRS及びGRITEKの事業計画の概要

単位：百万円



# 会社概要



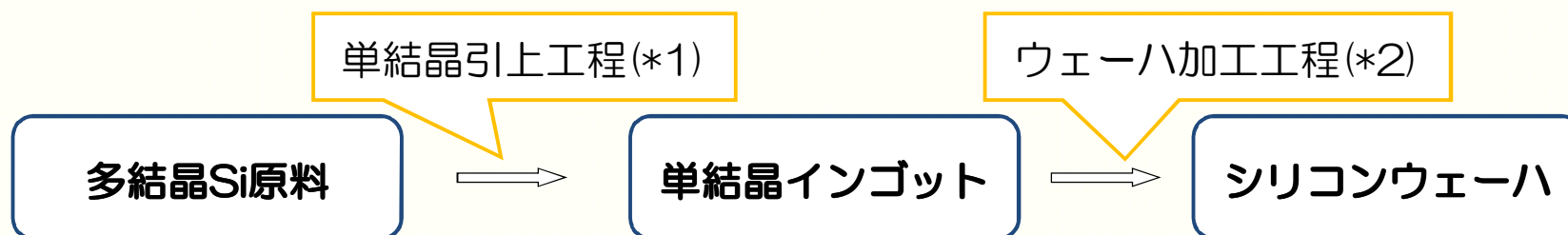
# GRITEKの会社概要



## 会社概要

社名	有研半導体材料有限公司
本社所在地	北京市順義区林河工業開発区双河路南側
代表者	董事長 周 旗鋼（2017年9月30日時点）
主要財務数値	売上高 約 360百万元 営業利益 約 28百万元 ※財務数値はいずれも2017年12月期第3四半期累計 総資産 約 581百万元 純資産 約 348百万元
従業員	636人 ※2017年4月末時点
事業内容	<ul style="list-style-type: none"><li>■ シリコンウェーハの生産、販売、開発、関連技術の開発等</li><li>■ CZインゴット、FZインゴットの生産、販売、開発、関連技術の開発等</li></ul>

# GRITEKの事業内容



(\*1)シリコンウェーハの材料となる単結晶インゴットの製造方法は、大きくCZ法・FZ法の2つに分けられる。  
CZ法：高純度多結晶シリコンを、ホウ酸やリンとともに石英ルツボに入れて融解させる。ルツボ内で融解したシリコンの液面に種結晶シリコン棒をつけ、回転させながら引き上げる。大口径の単結晶が作りやすい。  
FZ法：多結晶シリコンのインゴットを部分的に融解しながら単結晶を作る方法。CZ法と違って石英るつぼを使わず、異物と接触しないので、純度の高いシリコン単結晶が作ることが可能。  
有研半導体材料有限公司は、どちらにも対応している。  
(\*2)切断⇒粗研磨⇒エッチング（表面上のダメージを取り除く）⇒研磨⇒洗浄・検査